

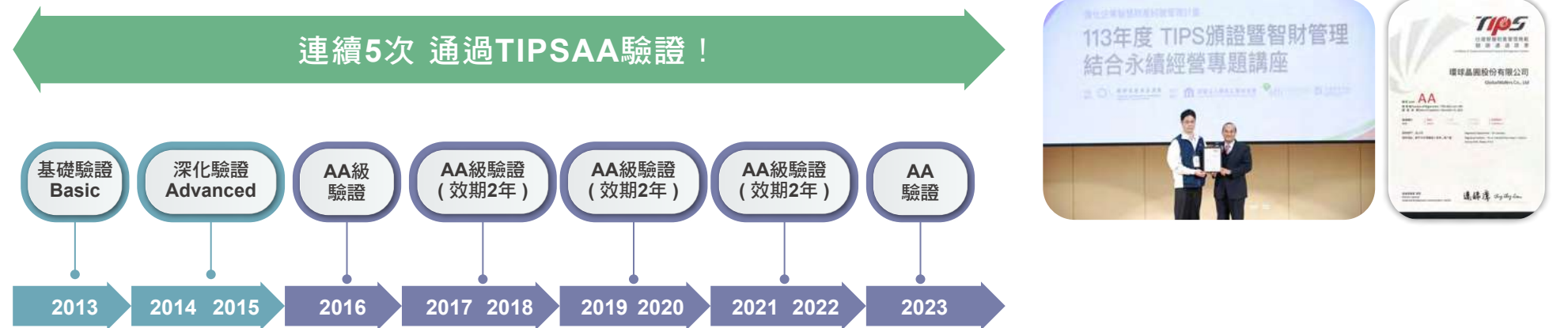


- 關於本報告書
- 2023 關鍵指標與肯定
- 經營者的話
- 關於環球晶圓
- 永續管理
- 氣候策略與行動
- 1 治理與營運
- 2 創新與服務
  - 2.1 創新管理
  - 2.2 產品品質
  - 2.3 客戶服務
  - 2.4 永續供應鏈管理
- 3 永續環境
- 4 人才發展與社會共融
- 5 職業健康與安全
- 附錄

### 2.1.2 智慧財產管理制度

環球晶圓於 2013 年導入台灣智慧財產管理制度 (Taiwan Intellectual Property Management System, TIPS)，依序建置管理流程且通過基礎驗證，持續於 2014、2015 年通過深入驗證，2016、2017、2019、2021、2023 年連續五次通過 AA 級驗證。透過建置系統化管理強化與提升公司的智財管理能量，並且受到第三方的認證與肯定。

#### ◎ TIPS 驗證歷程



#### ◎ 智財管理策略

- ★ 提升智財管理能力，厚植長期競爭實力
- ★ 鼓勵全員創新提案，強化產品專利佈局
- ★ 建立機密管理機制，保障公司客戶權益

透過 TIPS 的推導，智財管理政策以機密管制與專利佈局為主軸，配合營運與研發策略，考量集團以全球規模最大、產品最完整之晶圓供應商為目標，以運用核心技術能力建立新世代產品競爭力為研發策略，期望透過智財管理制度的運作提升智財管理能力，強化產品專利佈局、建構完善的機密管理機制，提升公司競爭力、保障公司及客戶權益。

#### ◎ 智財管理成果：多元專利佈局確保競爭優勢

制度執行上由研發單位主管做為管理代表，聯合智財單位與各單位執行代表組成推動團隊，每年定期舉辦內部稽核與管理審查，參與外部驗證確保管理制度的落實。在專利管理部份，建立專利管理程序確保專利產出品質，與創新開發團隊合作，對新產品或新技術加強專利佈局。

環球晶圓目前有效專利申請量為 493 件，申請範圍涵蓋廣泛，包括：(1) 矽基板長晶與加工技術，(2) 碳化矽晶圓晶體生長、加工、缺陷檢驗技術，(3) 氮化鎵磊晶技術，(4) 智慧製造與 AI 分析技術，從第一代半導體材料至新興科技之第三代半導體材料皆有佈局。若加上其他海外子公司，全集團有效專利申請量則累積達 2,310 件，包含 1,403 件已獲證與 907 件申請中專利（統計至 2023 年 12 月底）。



關於本報告書

2023 關鍵指標與肯定

經營者的話

關於環球晶圓

永續管理

氣候策略與行動

1 治理與營運

2 創新與服務

2.1 創新管理

2.2 產品品質

2.3 客戶服務

2.4 永續供應鏈管理

3 永續環境

4 人才發展與社會共融

5 職業健康與安全

附錄

### ◎風險與因應對策：強化機密管制降低洩密風險

有鑒於機密外洩事件於新聞上時有所聞，為了避免公司產出技術遭人剽竊，同時必須保障客戶權益，公司持續強化機密管制方案，避免可能的風險發生。在機密管制上分別針對人員、機密文件、設備與環境設施建立管理機制。人員部分提供智財教育訓練以提升員工對於機密管制的認知與危機意識；文件部分由各部門盤點列管文件、劃分機密等級，依序進行等級標示、權限控管、流通與銷毀管制；設備部分則針對私人電腦或電子儲存裝置進行使用管控；環境設施部分則是針對重要機房或生產作業區設定管制區，進行門禁與拍攝控管。每年透過內部稽核自我檢視，確認各部門於機密管制之落實程度。

#### 機密管理四大方向



智慧財產權對集團來說，可以彰顯技術發展能量，創造策略聯盟機會，提升公司整體競爭力，爭取客戶信賴與認同。尤其在發展新技術或新產品時，在該領域進行專利佈局，避免可能的智財風險相當重要。智慧財產權不只是開發下一世代產品的競爭利器，同時也是能夠抵禦所有競爭者造成影響、公司得以永續經營的重要利器。

## 2.2 產品品質

環球晶圓秉持持續改善、精益求精的精神，提供最優良的品質、技術和全方位的服務，提升產品的品質和公司競爭力；與客戶共同成長、與員工追求卓越、為股東創造價值，和我們的客戶一起追求永續經營。

為確保環球晶圓營運策略方向之有效推行，依公司的品質方針頒布「品質政策」內容，以做為全體員工之信條；我們承諾全方位的持續改善以達成極致卓越的品質、技術與生產製造，我們的目標是提供客戶零缺陷的產品與服務。

### ◎強化公司改善文化

環球晶圓各廠區積極投入品質管理活動，執行全方位的持續改善，精進製程技術以提升產品品質。各廠區成立 QIT (Quality Improvement Team) 品質改善小組，由各功能別部門成員共同組成，QIT 品質改善小組人員長期致力於製程研究與產品品質之改善，改善成果包含創新、創新高、成本效益、精實生產、產品競爭力、客戶滿意度、客訴的原因分析檢討改善、品質指標的製程能力…等項目，經由不斷改善與進步而臻於完善的境界，以提升公司產品的形象與競爭力。我們以零缺陷為永恆的目標，持續改進並與客戶一同成長，成為客戶的第一選擇。

環球晶圓在 2023 年參加「台灣持續改善競賽」，獲得團結組自主改善類 (品質 & 效率) 及專案改善類共二座銀塔獎殊榮，我們將持續改善、精進製程技術。

#### 斷片降降好圈 銀塔獎

改善主題：降低線切割製成斷片率



#### IE4.0 圈 銀塔獎

改善主題：節約能源度危機 共創減碳新契機

